

2026年12月16日

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム センシング材料WG

主査 藤尾侑輝

副査 上原雅人、蔭浦泰資

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム 令和7年度 第2回 センシング材料WG講演会のご案内

拝啓

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当コンソーシアムのWG活動に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

本WGでは、産総研が開発する世界トップクラスのセンシング材料：窒化物薄膜(ScAlN、ScGaN等)、ダイヤモンド、湿式酸化物薄膜等の最新の研究開発動向(材料開発、材料特性、製造方法)、社会課題に対する応用展開について、産総研、大学、企業の研究者を交えた議論を行っています。近年、ScAlNやScGaN、ZnMgOなどウルツ鉱型結晶において強誘電性が発見され、強誘電体の応用展開に新しい潮流が生まれています。従来のメモリデバイスやGaN-HEMTに加え、電気光学(EO)効果を活用した光通信・センシング分野への展開が期待され、産業界にとっても大きな可能性を秘めています。今回の講演会では、名古屋大学の山田智明教授に、強誘電体のナノスケール構造制御とEO特性に関する最先端の研究をご紹介いただきます。また、ウルツ鉱型強誘電体の研究動向についても共有し、次世代センシング技術やフォトニクス応用に向けた議論を深める場といたく、第2回センシング材料WG講演会を開催いたします。皆様の積極的なご参加をお待ちしております。

敬具

記

日時：2026年1月22日(木) 13:30～15:00 (13:15 受付開始)

会場：Microsoft Teamsを活用したオンライン会議

申込締切：2026年1月19日(月)

13:30～13:35 開会挨拶

センシング材料 WG 主査 藤尾 侑輝

13:35～14:25

招待講演「強誘電体ナノスケール構造の制御と圧電・電気光学特性」(仮題)

名古屋大学 大学院工学研究科 エネルギー理工学専攻 教授 山田 智明 先生

14:25～14:45

依頼講演「最近のウルツ鉱型強誘電体の研究動向について」(仮題)

産総研 センシング技術研究部門 上級主任研究員 上原 雅人

14:45～14:55 総合討論

14:55～15:00 閉会挨拶、事務連絡等

センシング材料 WG 主査 藤尾 侑輝

※プログラムは変更する可能性があります。

※個人情報は、コンソーシアム活動及びセンシング技術研究部門の広報活動に限定して使用させていただきます。

問い合わせ先：

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム センシング材料 WG 事務局

(国研)産業技術総合研究所 センシング技術研究部門内 E-mail: M-stri-SenTePack-material-ml@aist.go.jp